



## 半導体製造装置 組立責任者（海外拠点立ち上げ/マレーシア）

日本本社・顧客との連携を担いながら事業をリードいただきます。

### Job Information

**Recruiter**

Agensi Pekerjaan Asia Recruit Sdn Bhd

**Job ID**

1597468

**Industry**

Electronics, Semiconductor

**Job Type**

Permanent Full-time

**Location**

Malaysia

**Salary**

Negotiable, based on experience ~ 10 million yen

**Work Hours**

7:30 am – 5:00 pm

**Holidays**

完全週休2日制（土・日・祝祭日）

**Refreshed**

June 18th, 2026 19:37

### General Requirements

**Minimum Experience Level**

Over 6 years

**Career Level**

Mid Career

**Minimum English Level**

Business Level

**Minimum Japanese Level**

Fluent

**Minimum Education Level**

Bachelor's Degree

**Visa Status**

No permission to work in Japan required

### Job Description

**【仕事内容】**

- マレーシア拠点における半導体製造装置組立事業の統括責任者
- 組立・生産管理・調達の全体マネジメント
- 生産計画、進捗管理、納期管理の推進
- 組立現場における技術指導・トラブルシューティング（ハンズオン対応）
- 品質・納期・コスト（QDC）の達成責任
- 日本顧客および日本本社との主要窓口
- 進捗報告、技術課題、設計変更、リスク管理の調整・対応

- 組立工程の改善、標準化、Lean/Kaizen推進
- 組織構築およびチームマネジメント

【給与】

月給 最大RM20,000 (経験・スキルにより応相談)  
\* 日本円で最大約78万円  
\* 駐在採用の検討も可能

【福利厚生】

- 就労ビザサポートあり
- 医療保険
- 駐在採用の場合は別途パッケージ相談可 (住宅手当等)

---

## Required Skills

< 必須 >

- 半導体製造装置の組立・製造・据付いずれかの経験 10年以上
- 製造現場または組立部門のマネジメント経験 5年以上
- 装置組立の実務経験 (ハンズオン対応が可能な方)
- 顧客対応経験 (進捗・技術・納期調整など)
- 日本語: ビジネスレベル以上 (N1相当またはネイティブ)
- 英語: ビジネスレベル

< 歓迎 >

- 洗浄装置、搬送装置、検査装置、プロセス装置などの経験
- 日系メーカーでの勤務経験
- 海外工場立ち上げ・移管プロジェクト経験
- 日本顧客との直接折衝経験

---

## Company Description